1.はじめに

CFRP などの複合材は航空機などに多用され、 その検査法の確立が求められており、多数の研究 報告がされている¹⁻³。CFRP に対する非破壊検査 法としては超音波探傷やX線透過などが使われて いる様である。電磁誘導を利用した渦電流探傷法 は原理的に非接触で試験を行えるので、CFRP の 検査に適用できれば他の試験法にはないメリット を持つと考える。筆者らが知る限りではCFRP に 渦電流探傷を適用した報告は知らない。本報告で は、前プロジェクトで開発した従来の渦電流探傷 プローブよりも SN 比高くきず検出性能の高い プローブを用いた CFRP に対する渦電流探傷試験 結果について報告する。

2. プローブによる渦電流探傷試験

渦電流探傷 プローブの構造を図1に示す。 プローブは、円形の励磁コイルと矩形縦置の検出 コイルから構成される。円形の励磁コイルは、導 電性の試験体に電磁誘導により渦電流を誘導する。 矩形縦置の検出コイルは、欠陥などにより変化し た渦電流で作られ検出コイルに差鎖する磁束を検 出し、信号を発生する。



3.実験方法

実験に用いた プローブの励磁コイルの寸法は 外径9mm 巻線断面積1×1mm²であり、検出コイ ルの寸法は幅7mm高さ7mm 巻線断面積1×1mm² である。試験体には0.2mmのCFクロスを50枚 日大生産工 小山 潔、星川 洋

積層した厚さ 10mm の CFRP 板を用いた。CF ク ロスの繊維方向は0°と90°である。試験体には、 図 2 に示すように 1 辺 20mm、10mm、5mm 角で 厚み 0.5mm の UD を表面から深さ 1mm の位置に 挟み模擬はく離欠陥とした。模擬はく離欠陥は層 間で電気的に絶縁されている。CFRP の導電率は、 板面方向 (x、y 方向)に 7.7×10³S/m であり、板 厚さ方向 (z 方向)に 4.8×10¹S/m である。電磁誘 導で導電性の試験体に誘導される渦電流は、試験 体の導電率と試験周波数でその大きさが決まる。 CFRP の場合、導電率が小さいので誘導される渦 電流を大きくすることを考え、試験周波数を 500kHz とした。模擬はく離欠陥を中心として x、 y 方向に ± 25mm の範囲を 0.5mm 間隔でプローブ を走査した。



図2 CFRP 積層板と模擬はく離欠陥寸法

4.実験結果

図3には、模擬はく離欠陥が無いときの検出信 号を示す。図4には20mm角の模擬はく離欠陥、 図5には5mm角の模擬はく離欠陥の検出信号を 示す。各図(a)には励磁電流に同相成分(In-phase component)の信号を、図(b)には検出信号振幅の 濃淡画像を示す。模擬はく離欠陥が無い場合には、 検出信号は緩やかに波を打つが雑音は小さいこと がわかる。一方、模擬はく離欠陥が有る場合には、 はく離欠陥部に正負に振れる信号を得られ、はく 離欠陥をSN比高く検出していることがわかる。 また、はく離欠陥の大きさに応じて検出信号振幅 が変化していることがわかる。

Study on Electromagnetic Induction Non-Destructiveness Testing for CFRP.



5.まとめ

渦電流探傷による CFRP に対する模擬はく離欠陥の検出を試みた。実験の結果、今回の繊維方向



(b) 信号振幅の濃淡画像 図5 5mm 角模擬はく離欠陥の検出信号

0°と90°の CF クロスを積層した CFRP におい て、表面から約 1mm にある模擬はく離欠陥を検 出できることを確認した。CFRP で問題となる繊 維破断のマトリックス割れの検出や表面欠陥の検 出、また繊維方向が一方向を積層した CFRP など、 今後詳細に研究を進める予定である。

参考文献

- 1) 松嶋正道「CFRP の非破壊検査と評価法」 JSNDI 新素材の非破壊評価特別研究委員会資料、No.007-234, pp.1-2 (2005)
- 2) 上田政人、轟章、島村桂延伸、小林英男「電 位差法を用いた CFRP 積層板はく離モニタリ ング」日本複合材料学会誌、Vol.30, No.4, pp149-156 (2004)
- 3) 松崎亮介、轟章「電気抵抗変化法と発信周波 数変化を用いた CFRP 積層板の無線はく離検 出」日本機械学会論文集(A 編)、Vol.71, No.703, pp.152-159 (2005)
- H.Hoshikawa and K.Koyama, "A New Eddy Current Probe with Minimal Liftoff Noise and Phase Information on Discontinuity Depth", Materials Evaluation, Vol.61, No.3, pp.423-427 (2003)